財團法人工業技術研究院　函

地址：31040 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：李怡秋
電話：03-5917759
傳真：03-5910466
E-mail：Lislee@itri.org.tw

106001378406

241 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 6 號 3 樓之 3

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 106.08.07 文
檔號：106569

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會
發文日期：中華民國 106 年 08 月 04 日
發文字號：工研轉字第 1060013784 號
速別：普通件
密等：無
附件：如文

主旨：為本院「量測檢測暨生醫器材專利讓與案」公開招標事，敬請轉知 貴會會員等相關廠商重要資訊，把握機會參與本活動，請 查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智財防護能力，本院將辦理量測檢測暨生醫器材專利 45 案 74 件之讓與公開招標活動(詳如附件)。

二、有關本活動詳細資訊，請參考下列網站公告：

（一）工研院研發成果公告網站（https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1）

（二）台灣技術交易資訊網（https://www.twtm.com.tw/Web/news/trans.aspx）。

三、本案截標日為 106 年 9 月 4 日止，開標日為 106 年 9 月 5 日止。

四、公開說明會：

（一）舉辦時間：106 年 8 月 16 日 14 時。

（二）舉辦地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館

108 室。

（三）報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 106 年 8 月 15 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（請於電子郵件主旨上註明「量測檢測暨生醫器材專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。），聯絡人將於 106 年 8 月 15 日下午 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

五、本案聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 李小姐

電話：(03) 591-7759

傳真：(03) 582-0466

電子信箱：Lislee@itri.org.tw

地址：31040 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者： 台灣醫療暨生技器材工業同業公會

院長 劉仲明

依權責劃分規定授權業務主管決行

工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

工業技術研究院
量測檢測暨生醫器材專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含量測檢測暨生醫器材相關專利 45 案 74 件。以下簡稱「讓與標的」。「讓與標的」相關資訊詳如附件或請參考台灣技術交易資訊網（https://www.twtm.com.tw/Web/index.aspx）及工研院研發成果公告網站（https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1）。

四、公開說明會與領標：

1. 公開說明會將於民國（下同）106 年 8 月 16 日下午 14 時整於工研院中興院區 51 館 108 室舉辦。
2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 106 年 8 月 15 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「量測檢測暨生醫器材專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 106 年 8 月 15 日下午 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
3. 自本標案公告日起至截標日 106 年 9 月 4 日下午 17 時整(含)止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

1. 本標案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同押標金、公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本）、廠商基本資料表(以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「量測檢測暨生醫器材專利讓與案投

標」，於截標日 106 年 9 月 4 日下午 17 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：

31040 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

工研院技轉法律中心 李小姐 收

2. 本標案採「案」方式投標。「專利標的」以同一發明為一案。本標案採一案一標，即同一案專利不分開投標/開標。
3. 本標案不得共同投標或重複投標。
4. 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。
5. 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

1. 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以現金、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
3. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

1. 投標時間截止後之投標。
2. 開標前業已公告停止本標案交易程序。
3. 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
4. 投標單附加任何成交條件者。
5. 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
6. 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標前未能補足者，其投標為無效。

八、決標方法：

1. 開標日為 106 年 9 月 5 日(開標時間及地點另行通知投標廠商)。
2. 開標時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、廠商基本資料表進行審查及確認。
3. 同一案以投標廠商出價金額最高且高於底價者得標。同一案有二家（含）以上投標金額相同時，由工研院現場抽籤決之。
4. 開標時將請律師到場監標。
5. 開標後將個別通知投標廠商開標結果（不公告得標廠商）。
6. 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。

九、契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起 15 個工作天內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
2. 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格(但經工研院同意者，不在此限)；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
3. 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，需為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
4. 得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施等規定)。前述法令變動時，亦同。
5. 得標廠商取得「讓與標的」應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
6. 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。
7. 「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定需送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。
8. 得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與第三人時，並應使該第三人同意本條約定。再為專屬授權或讓與時亦同。
9. 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：1.工研院已與第三人簽訂之授權契約；2.工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及 3.工研院已承諾不會對特定之人行使專利權。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與他人時，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。
10. 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本標案公告日之「讓與標的」現狀辦理本標案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之尚在申請中之專利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠

商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「專利標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「專利標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責，概與工研院無涉；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「專利標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「專利標的」之諮詢講解或訓練之義務。

11. 「專利標的」之讓與登記手續由得標廠商負責辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「專利標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「專利標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。

12. 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之法令規定，配合工研院為一切必要之申請，並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院。得標廠商且應配合工研院向主管機關(包含但不限經濟部技術處，以下同)及立法院經濟委員會為境外實施等一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院、該主管機關及立法院經濟委員會核准及同意後始得為之：

（1）得標廠商在我國管轄區域外（係指台、澎、金、馬，下同）自行使用、實施者；

（2）得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

（3）得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域（係指臺、澎、金、馬）外製造或使用者；

（4）得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

13.得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得終止「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：

(1)得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。

(2)得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。

(3)為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

14. 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與第三人（以下稱「後手」）時，應將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。

15.得標廠商應使所有「後手」遵守本條第 8 項至第 10 項、第 12 項至第 14 項、及第 16 項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

16.基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對依中華民國法律設立之法人或中華民國國民就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「專利標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

17.得標廠商應盡力進行產品開發工作，得標廠商未於合理期間內運用「讓與標的」，工研院得以書面終止「讓與契約書」或將「讓與標的」非專屬授權他人實施，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院「技轉法律中心」聯絡人（請詳十三、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本標案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本公告相關問題請洽詢：

工研院「技轉法律中心」 李小姐

電話：(03) 591-7759，傳真：(03) 582-0466

電子信箱：Lislee@itri.org.tw

地址：31040 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

附件：

組合名稱	案號	件號	專利中文名稱	申請國家	狀態	申請案號	專利證號	成果來源	專利起期	專利迄期
量測檢測專利組合	1	1	全反射式光學開關	CN	獲證	01140399.3	ZL01140399.3	經濟部技術處	20050126	20211220
		2	全反射式光學開關	TW	獲證	90130793	163910	經濟部技術處	20020921	20211211
	2	3	紅外光譜、拉曼光譜及螢光光譜的量測光譜裝置	CN	獲證	01140215.6	ZL01140215.6	經濟部技術處	20060802	20211204
		4	紅外光譜、拉曼光譜及螢光光譜之量測光譜裝置	TW	獲證	90128816	168741	經濟部技術處	20021121	20211120
		5	紅外光譜、拉曼光譜及螢光光譜之量測光譜裝置	US	獲證	10/299,848	6,835,933	經濟部技術處	20041228	20230312
	3	6	改良式微型三維定位調整裝置	TW	獲證	90132424	180439	經濟部技術處	20030521	20211225
	4	7	熱釋電型感測器信號轉換電路	TW	獲證	91120971	197821	經濟部技術處	20040211	20220912
	5	8	手杖	TW	獲證	95305373	D119170	經濟部技術處	20071001	20180924
		9	手杖	TW	獲證	95305374	D120169	經濟部技術處	20071201	20180924
	6	10	力量感測器	TW	獲證	92120435	I230791	經濟部技術處	20050411	20230724
	7	11	雙波混合於光折變晶體干涉裝置	TW	獲證	92131262	I221897	經濟部技術處	20041011	20231106
	8	12	消除極化相關性的光譜測量裝置及其方法	CN	獲證	200410074770.7	ZL200410074770.7	經濟部技術處	20081210	20240913
		13	清除極化相關性之光譜量測裝置及其方法	TW	獲證	93126338	I248512	經濟部技術處	20060201	20240831
	9	14	表面形貌掃描裝置	TW	獲證	93129029	I282851	經濟部技術處	20070621	20240923
	10	15	雙通型光譜量測裝置及其極化相關性之消除方法	TW	獲證	93131778	I259902	經濟部技術處	20060811	20241019
	11	16	共焦顯微量測系統	TW	獲證	93138922	I258598	經濟部技術處	20060721	20241214
	12	17	微液滴控制裝置、製造方法、控制方法及數位流體檢測平台	TW	獲證	93141733	I262309	經濟部技術處	20060921	20241230
	13	18	准共光程外差干涉位移測量系統	CN	獲證	200510132985.4	ZL200510132985.4	經濟部技術處	20100505	20251230
		19	準共光程外差干涉位移量測系統	TW	獲證	94147542	I270663	經濟部技術處	20070111	20251229
	14	20	電光取樣裝置與方法	TW	獲證	94146908	I295376	經濟部技術處	20080401	20251227
	15	21	陣列式電極控制裝置及其數位流體檢測平台	TW	獲證	94145456	I303312	經濟部技術處	20081121	20251220
		22	陣列式電極控制裝置及其數位流體檢測平台	US	獲證	12/908,274	8,465,638	經濟部技術處	20130618	20270330
	16	23	具有保護能力的電壓驅	CN	獲證	200510003356.1	ZL200510003356.1	經濟部	20090311	20251229

組合名稱	案號	件號	專利中文名稱	申請國家	狀態	申請案號	專利證號	成果來源	專利起期	專利迄期
			動控制系統及方法					技術處		
		24	具有保護能力之電壓驅動控制系統及方法	TW	獲證	94147076	I305694	經濟部技術處	20090121	20251227
	17	25	擷取可撓曲物體表面影像的裝置與方法	CN	獲證	200510003570.7	ZL200510003570.7	經濟部技術處	20090708	20251229
		26	擷取可撓曲物體表面影像的裝置與方法	TW	獲證	94146578	I305105	經濟部技術處	20090101	20251225
	18	27	以信號波形分析為基礎之符元速率測試方法	TW	獲證	95149972	I334711	工研院	20101211	20261228
		28	以信號波形分析為基礎之符元速率測試方法	US	獲證	11/688,880	7,957,459	工研院	20110607	20300405
	19	29	自動對焦搜尋方法	TW	獲證	95148354	I324015	經濟部技術處	20100421	20261221
		30	自動對焦搜尋方法	US	獲證	11/955,215	7,929,044	經濟部技術處	20110419	20300214
	20	31	薄膜折射率與厚度量測方法及其裝置	TW	獲證	96110106	I357977	經濟部技術處	20120211	20270322
	21	32	相位式探針感測結構	TW	獲證	95149423	I305828	經濟部技術處	20090201	20261227
	22	33	掃瞄式電子顯微鏡	TW	獲證	96103854	I333224	經濟部技術處	20101111	20270201
	23	34	檢測系統的光源散射照明裝置	CN	獲證	200710098148.3	ZL200710098148.3	經濟部技術處	20110921	20270416
	24	35	高光譜解析度之取像系統及其取像方法	TW	獲證	96109046	I345053	經濟部技術處	20110711	20270315
		36	高光譜解析度之取像系統及其取像方法	US	獲證	11/757,281	7,586,073	經濟部技術處	20090908	20270531
	25	37	影像調整方法及影像擷取裝置	CN	獲證	200710130600.X	ZL200710130600.X	經濟部技術處	20110629	20270717
		38	影像調整方法及影像擷取裝置	TW	獲證	96124430	I336767	經濟部技術處	20110201	20270704
		39	影像調整方法及影像擷取裝置	US	獲證	12/058,926	8,005,290	經濟部技術處	20110823	20300622
		40	影像調整方法及影像擷取裝置	US	獲證	13/177,168	8,237,933	經濟部技術處	20120807	20280330
	26	41	聲音感測器安裝裝置	TW	獲證	96138110	I340601	工研院	20110411	20271011
	27	42	表面形貌量測方法及其裝置	CN	獲證	200710181614.4	ZL200710181614.4	經濟部技術處	20101124	20271018
		43	表面形貌量測方法及其裝置	TW	獲證	96132181	I352799	經濟部技術處	20111121	20270829
	28	44	光學式非球面測量系統及其平台	CN	獲證	200710152071.3	ZL200710152071.3	經濟部技術處	20110126	20271008
		45	光學式非球面量測系統及其平台	TW	獲證	96137645	I340234	經濟部技術處	20110411	20271007
	29	46	影像重建方法	TW	獲證	96145080	I342524	經濟部技術處	20110521	20271127
	30	47	氣囊式重量檢測裝置	GB	獲證	EP08103023.1	EP2081001	工研院	20141217	20280326
		48	氣囊式重量檢測裝置	TW	獲證	97101903	I361272	工研院	20120401	20280117
		49	氣囊式重量檢測裝置	TW	獲證	96307139	D125310	工研院	20081011	20191230
		50	甜甜圈狀重量檢測裝置	TW	獲證	96307137	D125309	工研院	20081011	20191230

組合名稱	案號	件號	專利中文名稱	申請國家	狀態	申請案號	專利證號	成果來源	專利起期	專利迄期
	31	51	調息狀態的分析方法及運用該分析方法的互動系統	CN	獲證	200810095479.6	ZL200810095479.6	經濟部技術處	20110518	20280423
	32	52	反射式散射儀	JP	獲證	2008-256583	4823289	經濟部技術處	20110916	20280930
		53	反射式散射儀	TW	獲證	97133614	I408356	經濟部技術處	20130911	20280901
		54	反射式散射儀	US	獲證	12/352,069	7,864,324	經濟部技術處	20110104	20290902
	33	55	干涉相位差顯微鏡	CN	獲證	200810171601.3	ZL200810171601.3	經濟部技術處	20111123	20281020
	34	56	平面移動裝置	TW	獲證	97139664	I348009	經濟部技術處	20110901	20281015
	35	57	負折射光子晶體透鏡	US	獲證	12/383,720	7,864,449	經濟部技術處	20110104	20290505
	36	58	可攜式氣墊裝置	DE	獲證	DE102009022603.6	102009022603	工研院	20110915	20290525
		59	可攜式氣墊裝置	TW	獲證	98110525	I391109	工研院	20130401	20290329
生醫器材專利組合	37	60	生物細胞自動處理裝置及方法	TW	獲證	92116722	I314991	經濟部技術處	20090921	20230618
	38	61	電動輪椅	CN	獲證	200510137569.3	ZL200510137569.3	經濟部技術處	20120307	20251229
		62	電動輪椅之輔助裝置	TW	獲證	94147084	I288635	經濟部技術處	20071021	20251227
	39	63	椅背按摩裝置及其擺置、前推、揉搓與捶打機構	CN	獲證	200510135790.5	ZL200510135790.5	經濟部技術處	20100512	20251228
		64	椅背按摩裝置	TW	獲證	94146340	I288636	經濟部技術處	20071021	20251222
		65	椅背按摩裝置	US	獲證	11/551,686	7,731,671	經濟部技術處	20100608	20290217
	40	66	吞入式內視鏡的結構	CN	獲證	200610000405.0	ZL200610000405.0	經濟部技術處	20090527	20260104
		67	吞入式內視鏡之結構	TW	獲證	94147143	I284027	經濟部技術處	20070721	20251228
	41	68	細胞切割機	TW	獲證	95149895	I316853	經濟部技術處	20091111	20261228
		69	細胞切割機	US	獲證	11/741,716	7,883,666	經濟部技術處	20110208	20291207
	42	70	心肺復甦輔助裝置	TW	獲證	95148159	I319982	經濟部技術處	20100201	20261220
	43	71	按摩椅之按摩方法及其裝置	TW	獲證	95149336	I306759	經濟部技術處	20090301	20261226
	44	72	開瓶工具	TW	獲證	96110935	I311543	經濟部技術處	20090701	20270328
	45	73	開瓶工具	IT	獲證	RM2007A000682	IT0001379329	經濟部技術處	20100830	20271230
		74	開瓶工具	TW	獲證	96120678	I315293	經濟部技術處	20091001	20270607